



THERMAL SYSTEMS

Presseinformation

04.04.2022

Rehm präsentiert Vakuumtechnologien auf der SMART SMT & PCB Assembly in Korea

Vom 6. – 8. April 2022 ist Rehm auf einer der wichtigsten koreanischen Fachmessen im Suwon-Convention-Center vertreten und präsentiert neueste Anlagen- und Systemtechnik aus den Bereichen Reflow-Löten mit Konvektion und Kondensation in Kombination mit Vakuumprozessen.

Die Smart SMT & PCB Assembly (SSPA) findet im Suwon-Convention-Center, einem zentralen Standort für die Elektronikindustrie statt. Mit 200 Ausstellern und rund 12.000 Besuchern ist sie eine der wichtigsten Messen in Korea für die Elektronikfertigung. Neben zahlreichen Ausstellern aus den Bereichen SMT-Fertigung, Halbleiter-Equipment, Automatisierungslösungen für die Produktion und Software erwartet die Besucher ein Tagungsprogramm mit Fachvorträgen zu den aktuellen Trends in der Elektronikfertigung. An Stand E110, Ebene 1 präsentieren wir Ihnen das Reflow-Konvektionslötssystem VisonXP+ VAC sowie das Dampfphasenlötssystem CondensoXC. Unser Team vor Ort berät Sie gerne und freut sich auf Ihr Kommen!

VisionXP+ VAC: Das innovative System für das Reflow-Konvektionslöten mit Vakuummodul ist jetzt noch effizienter! Auf der NEPCON Korea präsentiert Rehm die Highlights der VisionXP+, z.B. den Einsatz neuer EC-Lüftermotoren, die nicht nur leiser und nachhaltiger sind, sondern auch eine umfangreiche Betriebsdatenerfassung ermöglichen, eine leistungsstärkere Kühlstrecke und Optimierungen im Design. Das Vakuummodul sorgt für voidfreies Löten und dadurch zuverlässige Baugruppen für die anspruchsvollsten Anwendungen.

CondensoXC: Das Dampfphasen - Lötssystem CondensoXC ist durch die innovative Prozesskammer kompakt gebaut und groß in der Performance. Durch das patentierte Injektionsprinzip wird dem Prozess exakt die richtige Menge Galden® zugeführt, für optimale Profilierungen. Über das Closed-Loop-Filterssystem kann das Medium zu nahezu 100 % zurückgewonnen und gefiltert werden. Die Anlage ist voll vakuumtauglich und verfügt über einen integrierten Prozessrecorder – für optimale Traceability.

Bilder: Prozesskammer mit Vakuummodul VisionXP+ VAC, CondensoXC (Rehm Thermal Systems)

Rehm Thermal Systems GmbH
Leinenstraße 7
89143 Blaubeuren-Seissen

Pressekontakt:

Carmen Hilsenbeck
Tel.: +49 73 44-96 06 535
Fax: +49 73 44-96 06 525
c.hilsenbeck@rehm-group.com
www.rehm-group.com



THERMAL SYSTEMS

Über Rehm Thermal Systems

Die Firma Rehm zählt als Spezialist im Bereich thermische Systemlösungen für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie zu den Technologie- und Innovationsführern in der modernen und wirtschaftlichen Fertigung elektronischer Baugruppen. Als global agierender Hersteller von Reflow-Lötsystemen mit Konvektion, Kondensation oder Vakuum, Trocknungs- und Beschichtungsanlagen, Funktionstestsystemen, Equipment für die Metallisierung von Solarzellen sowie zahlreichen kundenspezifischen Sonderanlagen sind wir in allen relevanten Wachstumsmärkten vertreten und realisieren als Partner mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung innovative Fertigungslösungen, die Standards setzen.